

平成21年3月期 第1四半期決算短信

平成20年8月8日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社
 コード番号 8035 URL <http://www.tel.com/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 潔
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 佐伯 幸雄
 四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

上場取引所 東

TEL 03-5561-7000

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期第1四半期	154,827	—	21,430	—	22,263	—	12,853	—
20年3月期第1四半期	212,494	18.6	43,034	66.4	41,175	54.0	26,192	60.9

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第1四半期	71.83	71.69
20年3月期第1四半期	146.45	146.04

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
21年3月期第1四半期	753,206	548,275	548,275	71.4	71.4	3,006.09
20年3月期	792,817	545,244	545,244	67.5	67.5	2,989.70

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 537,891百万円 20年3月期 534,953百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
20年3月期	—	70.00	—	55.00	125.00
21年3月期	—	—	—	—	—
21年3月期(予想)	—	19.00	—	21.00	40.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 有

3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期連結累計期間	301,500	—	22,500	—	25,000	—	15,000	—	83.83
通期	630,000	△30.5	51,000	△69.7	55,000	△68.2	33,000	△68.9	184.43

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(注) 詳細は、4ページ「定性的情報・財務諸表等 4. その他」をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注) 詳細は、4ページ「定性的情報・財務諸表等 4. その他」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期第1四半期 180,610,911株 20年3月期 180,610,911株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 1,676,808株 20年3月期 1,678,927株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第1四半期 178,932,452株 20年3月期第1四半期 178,852,766株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 平成20年5月13日に公表いたしました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。

2. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「定性的情報・財務諸表等 3. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

3. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の連結業績は、売上高1,548億2千7百万円(前年同期比27.1%減)、営業利益214億3千万円(前年同期比50.2%減)、経常利益222億6千3百万円(前年同期比45.9%減)、四半期純利益128億5千3百万円(前年同期比50.9%減)となりました。事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。

(1) 産業用電子機器事業

当セグメントの外部顧客に対する売上高は、1,299億4百万円(前年同期比30.7%減)となりました。

① 半導体製造装置

半導体市況低迷に伴い、前期後半から顕著となった半導体メーカーの設備投資抑制の影響により、台湾などの主要地域で販売が減少しました。この結果、当部門の外部顧客に対する売上高は1,125億4千6百万円(前年同期比32.1%減)となりました。

② FPD製造装置

当部門の外部顧客に対する売上高は172億6千4百万円(前年同期比19.3%減)となりました。しかしながら、パネル需要が好調に推移したことにより、パネルメーカーの設備投資は大型基板向けを中心に需要は回復してきており、当部門の売上も前下半期の調整局面と比較しますと、増加基調となっております。

③ その他

当部門の外部顧客に対する売上高は9千3百万円(前年同期比29.5%減)となりました。

(2) 電子部品・情報通信機器事業

半導体及び電子デバイス分野の売上が堅調に推移しましたが、コンピュータシステム分野の投資が減少したことにより、当セグメントの外部顧客に対する売上高は、249億2千3百万円(前年同期比1.0%減)となりました。

(ご参考) 【連結】

(単位:百万円)

	当期第1Q	前期通期				
		前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	
売上高	154,827	906,091	212,494	263,883	199,837	229,876
産業用電子機器事業	129,904	794,910	187,318	235,787	170,857	200,947
半導体製造装置	112,546	726,439	165,785	213,465	160,739	186,449
日本	32,896	191,934	31,614	63,015	52,248	45,055
米国	18,909	108,708	21,111	31,367	22,302	33,925
欧州	7,900	36,929	7,922	6,524	4,157	18,324
韓国	14,842	73,212	21,432	19,689	15,581	16,508
台湾	25,724	254,972	62,517	79,417	53,639	59,398
中国	3,788	29,864	13,848	6,677	4,188	5,150
東南アジア他	8,484	30,819	7,338	6,773	8,620	8,086
FPD製造装置	17,264	68,016	21,400	22,200	10,048	14,367
その他	93	454	132	121	69	130
電子部品・情報通信機器事業	24,923	111,181	25,175	28,095	28,980	28,929
営業利益	21,430	168,498	43,034	51,970	38,499	34,993
経常利益	22,263	172,713	41,175	54,620	39,761	37,155
四半期(当期)純利益	12,853	106,271	26,192	36,270	25,600	18,207

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態

当第1四半期末の総資産は、主に売掛金の減少により前期末から396億1千万円減少の7,532億6百万円となりました。負債合計は、法人税等の支払、買掛金の減少等により前期末から426億4千1百万円減少の2,049億3千1百万円となりました。純資産は、四半期純利益128億5千3百万円を計上したことによる増加、剰余金の配当98億4千1百万円による減少等の結果、前期末から30億3千万円増加の5,482億7千5百万円となり、自己資本比率は71.4%となりました。

(2) キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の第1四半期末残高は、前期末に比べ241億4千9百万円増加し、2,176億4千2百万円となりました。なお、当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況等は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、346億6千万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益222億5千3百万円、減価償却費51億1千万円、売上債権の減少456億6千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払265億6千3百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として生産・研究開発用有形固定資産の取得等による支出63億円、定期預金の減少による収入89億6千9百万円により、6億3千5百万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払98億4千1百万円により100億4千7百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済環境につきましては、エネルギー・原材料価格の高騰、米国におけるサブプライムローン問題を背景に、景気の下振れリスクが高まっております。半導体関連市場につきましては、DRAM、フラッシュメモリーの市況低迷により、半導体メーカーの設備投資の回復が当初の予想より遅れる見通しとなっております。このような状況のもと、主力の半導体製造装置部門の売上が期初予想を下回る見込みとなったことにより、平成20年5月13日に公表した第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。

平成21年3月期の連結業績予想

	第2四半期連結累計期間	通期
売上高	3,015億円 (前年同期比36.7%減)	6,300億円 (前年同期比30.5%減)
産業用電子機器事業	2,480億円 (前年同期比41.4%減)	5,170億円 (前年同期比35.0%減)
半導体製造装置	2,068億円 (前年同期比45.5%減)	4,205億円 (前年同期比42.1%減)
FPD製造装置	410億円 (前年同期比6.0%減)	960億円 (前年同期比41.1%増)
その他	2億円 (前年同期比21.5%減)	5億円 (前年同期比10.0%増)
電子部品・情報通信機器事業	535億円 (前年同期比0.4%増)	1,130億円 (前年同期比1.6%増)
営業利益	225億円 (前年同期比76.3%減)	510億円 (前年同期比69.7%減)
経常利益	250億円 (前年同期比73.9%減)	550億円 (前年同期比68.2%減)
当期(四半期)純利益	150億円 (前年同期比76.0%減)	330億円 (前年同期比68.9%減)

(注) この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

② 税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

当第1四半期連結会計期間から「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

たな卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第1四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)を適用し、主として個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

当第1四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

5. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	50,050	67,540
受取手形及び売掛金	179,427	224,170
有価証券	168,681	136,022
商品及び製品	102,872	101,053
仕掛品	41,536	42,123
原材料及び貯蔵品	17,630	17,974
その他	36,428	51,411
貸倒引当金	△58	△62
流動資産合計	596,567	640,233
固定資産		
有形固定資産	105,672	104,105
無形固定資産		
のれん	667	727
その他	12,240	12,525
無形固定資産合計	12,907	13,253
投資その他の資産		
その他	38,360	35,526
貸倒引当金	△301	△301
投資その他の資産合計	38,059	35,224
固定資産合計	156,638	152,584
資産合計	753,206	792,817
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	46,934	55,332
短期借入金	6,007	6,069
未払法人税等	10,992	28,239
製品保証引当金	8,886	9,815
その他の引当金	2,946	13,701
その他	79,765	85,662
流動負債合計	155,534	198,820
固定負債		
退職給付引当金	44,439	43,704
その他の引当金	639	665
その他	4,317	4,382
固定負債合計	49,397	48,752
負債合計	204,931	247,572

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,392	78,392
利益剰余金	413,324	410,866
自己株式	△11,357	△11,369
株主資本合計	535,320	532,850
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,531	2,172
繰延ヘッジ損益	△93	460
為替換算調整勘定	1,133	△529
評価・換算差額等合計	2,571	2,102
新株予約権	590	483
少数株主持分	9,792	9,807
純資産合計	548,275	545,244
負債純資産合計	753,206	792,817

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	当第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)
売上高	154,827
売上原価	102,729
売上総利益	52,098
販売費及び一般管理費	
研究開発費	14,562
その他	16,106
販売費及び一般管理費合計	30,668
営業利益	21,430
営業外収益	
受取利息	403
補助金収入	529
その他	310
営業外収益合計	1,242
営業外費用	
為替差損	211
その他	197
営業外費用合計	409
経常利益	22,263
特別利益	
固定資産売却益	25
その他	1
特別利益合計	26
特別損失	
固定資産除売却損	35
特別損失合計	35
税金等調整前四半期純利益	22,253
法人税等	9,237
少数株主利益	163
四半期純利益	12,853

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	22,253
減価償却費	5,110
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	732
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△9,913
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△1,069
受取利息及び受取配当金	△451
売上債権の増減額 (△は増加)	45,665
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△550
仕入債務の増減額 (△は減少)	△8,996
未収消費税等の増減額 (△は増加)	13,612
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△4,012
前受金の増減額 (△は減少)	764
その他	△2,428
小計	60,716
利息及び配当金の受取額	536
利息の支払額	△28
法人税等の支払額	△26,563
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の増減額 (△は増加)	8,969
有形固定資産の取得による支出	△6,300
無形固定資産の取得による支出	△376
投資有価証券の取得による支出	△2,783
その他	△144
投資活動によるキャッシュ・フロー	△635
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△62
配当金の支払額	△9,841
その他	△144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,047
現金及び現金同等物に係る換算差額	105
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	24,082
現金及び現金同等物の期首残高	193,492
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	67
現金及び現金同等物の四半期末残高	217,642

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)

(単位:百万円)

	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
売上高	130,175	25,062	155,237	(410)	154,827
営業利益	20,765	656	21,422	7	21,430

(注) 1 事業の区分は、製品及び役務の種類、販売方法等の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

事業区分	主な製品
産業用電子機器	半導体製造装置、FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)製造装置、その他
電子部品・情報通信機器	半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、ミドルウェア・ソフトウェア、その他電子部品等

3 会計処理の方法の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「定性的情報・財務諸表等 4.その他」に記載のとおり、たな卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第1四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成18年7月5日企業会計基準第9号)を適用し、主として個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。この変更に伴う影響は軽微であります。

(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「定性的情報・財務諸表等 4.その他」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会平成18年5月17日実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更に伴う影響は軽微であります。

② 所在地別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)

(単位:百万円)

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高	147,308	32,690	179,998	(25,171)	154,827
営業利益	19,034	2,014	21,048	381	21,430

(注) 1 国又は地域別の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他の地域に属する主な国又は地域

米国、欧州、台湾

3 会計処理の方法の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「定性的情報・財務諸表等 4.その他」に記載のとおり、たな卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第1四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成18年7月5日企業会計基準第9号)を適用し、主として個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。この変更に伴う影響は軽微であります。

(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「定性的情報・財務諸表等 4.その他」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会平成18年5月17日実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更に伴う影響は軽微であります。

③ 海外売上高

当第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)

(単位:百万円)

	台湾	韓国	米国	その他	計
海外売上高	31,249	21,187	18,918	24,136	95,491
連結売上高					154,827
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	20.2	13.7	12.2	15.6	61.7

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
 2 その他に属する主な国
 シンガポール、中国、イスラエル
 3 海外売上高は、当グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

「参考資料」

(要約) 前第1四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成19年 6 月 30 日)
	金 額
売 上 高	212,494
売 上 原 価	135,907
売 上 総 利 益	76,586
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	33,551
営 業 利 益	43,034
営 業 外 収 益	1,061
営 業 外 費 用	2,920
経 常 利 益	41,175
特 別 利 益	1,380
特 別 損 失	72
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	42,483
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	16,088
法 人 税 等 調 整 額	—
少 数 株 主 利 益	202
四 半 期 純 利 益	26,192

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

(単位：百万円)

事業部門	前第1四半期連結累計期間 〔自平成19年4月1日 至平成19年6月30日〕	当第1四半期連結累計期間 〔自平成20年4月1日 至平成20年6月30日〕
	生産高	生産高
産業用電子機器	218,237	119,960
半導体製造装置	194,860	97,025
F P D製造装置	23,376	22,934
合計	218,237	119,960

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

(単位：百万円)

事業部門	前第1四半期連結累計期間 〔自平成19年4月1日 至平成19年6月30日〕		当第1四半期連結累計期間 〔自平成20年4月1日 至平成20年6月30日〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
産業用電子機器	149,519	434,381	104,803	286,646
半導体製造装置	145,238	386,421	72,787	144,886
F P D製造装置	4,148	47,959	31,922	141,760
その他	132	-	93	-
電子部品・情報通信機器	27,552	16,469	26,080	14,372
合計	177,071	450,850	130,883	301,019

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

(単位：百万円)

事業部門	前第1四半期連結累計期間 〔自平成19年4月1日 至平成19年6月30日〕	当第1四半期連結累計期間 〔自平成20年4月1日 至平成20年6月30日〕
	販売高	販売高
産業用電子機器	187,318	129,904
半導体製造装置	165,785	112,546
F P D製造装置	21,400	17,264
その他	132	93
電子部品・情報通信機器	25,175	24,923
合計	212,494	154,827

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。